

电子

22Q1: 晶圆代工厂业绩创新高, 硅晶圆供不应求

台积电 2022Q1 营收创历史最高。台积电公布 2022 年 3 月营收报告显示 3 月台积电合并营收新台币 1719.67 亿, 同比增长 33.18%, 环比增长 17.04%。自 2022 年 1 月创下历史当月最高营收后, 3 月再一次创下历史同期最高营收, 根据公司披露信息统计, 台积电 2022Q1 实现营收 4710.76 亿新台币, 同比增长 35.50%, 成为历史最高单季营收。公司给出 2022 年 CaPex 指引 400-440 亿美金 (2021 年 300 亿美金), 其中 70-80% 用于先进制程, 包括 2/3/5/7nm; 10% 用于先进封装及掩膜版制造; 10-20% 用于特殊工艺。

联电&世界先进: 月度、季度营收创历史新高。联电公布 3 月财报, 3 月实现营收 221.4 亿新台币, 同比增长 33.22%, 环比增长 6.40%。2022Q1 联电累计营收 634.23 亿新台币, 同比增长 34.66%。世界先进发布公告, 公司在 2022 年 3 月实现营收 50.68 亿新台币, 同比增长 41.42%, 环比增长 19.40%。2022Q1 世界先进实现营收 134.92 亿新台币, 同比增长 46.97%。联电与世界先进在 3 月和 2022Q1 均实现了月度、季度的历史最高营收。

坚定看好 12 英寸硅片发展。半导体硅片发展和半导体产业景气度高度契合, 2017 年以来, 得益于半导体终端市场需求强劲, 半导体市场规模不断增长, 于 2018 年突破百亿美元大关。至 2020 年全球半导体硅片的收入已经达到 112 亿美元的规模, 且至 2021 年出货量有望也达到了 143 亿平方英寸。未来随着全球晶圆厂的持续扩张, 并且主要的方向将会集中在 12 寸晶圆上, 我们认为硅片行业的主要发展方向将会集中在 12 寸硅片上。

2022Q1 晶圆厂商业绩亮眼, 扩产步伐稳健。

环球晶圆: 22Q1 累计实现营收 163.07 亿新台币, 同比增长 10.14%, 为历史最高营收, 公司表示目前晶圆产能吃紧依旧, 2022~2024 产能均已售空。同时意大利的子公司 MEMC SPA 将新建 12 英寸晶圆的产线, 并且有望在 2023 年下半年开出产能。

立昂微: 发布公告, 公司 2022 年第一季度实现归母净利润 2.15~2.45 亿, 同比增长 183.66%~223.24%。同时 2 月立昂微宣布收购国晶半导体 58.69% 股权, 进一步扩大 12 英寸硅片产能。

沪硅产业: 2022 年 1~2 月公司实现营收 5.11 亿, 同比增长约 51%; 扣非归母净利润-806 万, 减亏约 2376 万, 约为 74%。公司定增拟总投资 46 亿元用于研发及扩产用于先进制程的 12 英寸硅片, 投产后新昇二期将新增产能 30 万片/月, 此外公司还将投资 21.44 亿元用于 12 英寸 SOI 硅片, 新傲将完成建设 SOI 产能 40 万片/年。

高度重视国内半导体及汽车产业格局将迎来空前重构、变化, 以及消费电子细分赛道龙头:

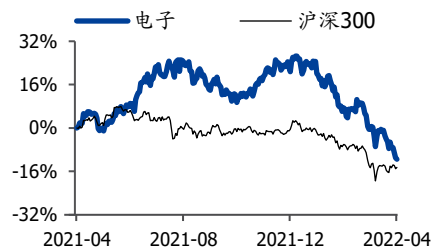
1) 半导体核心设计: 光学芯片、存储、模拟、射频、功率、FPGA、处理器及 IP 等产业机会; 2) 半导体代工、封测及配套服务产业链; 3) 智能汽车核心标的; 4) VR、Miniled、面板、光学、电池等细分赛道; 5) 苹果产业链核心龙头公司。

相关核心标的见尾页投资建议

风险提示: 下游需求不及预期; 中美贸易摩擦。

增持 (维持)

行业走势



作者

分析师 郑震湘

执业证书编号: S0680518120002

邮箱: zhengzhenxiang@gszq.com

分析师 余凌星

执业证书编号: S0680520010001

邮箱: shelingxing@gszq.com

相关研究

- 《电子: 华为 2021 研发投入创新高, 国产设备材料加速成长》2022-04-05
- 《电子: 半导体材料系列: 硅片—全球供需紧张窗口期, 国产替代加速》2022-04-02
- 《电子: 意法 Q2 全产品线预期涨价, 行业景气度超预期》2022-03-27

内容目录

一、22Q1全球晶圆代工收入亮眼，全球资本开支有望新高.....	4
1.1 台积电3月营收亮眼，一季度营收创新高.....	4
1.2 联电 & 世界先进：月度、季度营收创历史新高.....	6
1.3 2022全球半导体资本开支有望再创新高.....	10
二、硅晶圆供应持续紧张，晶圆厂22Q1业绩亮眼.....	13
2.1 硅片行业景气度迎接数年上行周期.....	13
2.2 晶圆厂2022一季度业绩亮眼.....	16
三、投资建议.....	18
四、风险提示.....	19

图表目录

图表 1: 台积电季度营收及增速情况 (新台币亿元, %)	4
图表 2: 台积电季度净利润及增速情况 (新台币亿元, %)	4
图表 3: 台积电季度毛利率情况 (%)	4
图表 4: 台积电 2021Q4 营收下游应用结构	5
图表 5: 台积电 2021Q4 营收技术节点结构	5
图表 6: 台积电资本开支情况 (2022 年取指引中值)	5
图表 7: 联电季度营收及增速情况 (新台币亿元, %)	6
图表 8: 联电季度毛利率情况 (%)	7
图表 9: 联电季度 ASP 趋势	7
图表 10: 2021 全年联电收入结构 (分制程)	8
图表 11: 联电 21Q4 产能使用情况及 22Q1 产能使用预期	8
图表 12: 世界先进季度营收及增速情况 (新台币亿元, %)	9
图表 13: 世界先进收入结构	10
图表 14: 全球半导体资本开支	11
图表 15: 全球 2022 资本支出增速超 40% 的部分公司	11
图表 16: 2021 年预计代工占资本开支 35%	12
图表 17: 全球半导体市场规模及 Capex 支出增速对比	12
图表 18: 全球半导体硅片收入 (亿美元)	13
图表 19: 全球半导体硅片出货面积 (百万平方英寸)	13
图表 20: 全球 12 寸半导体硅片需求	14
图表 21: 中国大陆半导体硅片市场规模 (亿美元)	14
图表 22: 全球硅片市场竞争格局及市占率	14
图表 23: 全球硅片产能及需求变化情况及预测	15
图表 24: 下游晶圆厂库存采购、需求、及库存、库存周转天数情况	15
图表 25: 下游晶圆厂库存采购、需求、及库存、库存周转天数情况 (逻辑及存储芯片)	15
图表 26: 环球晶圆季度营收及增速情况 (新台币亿元, %)	16
图表 27: 环球晶圆月度营收及增速情况 (新台币亿元, %)	16
图表 28: 立昂微营收及增速 (亿元, %)	17
图表 29: 立昂微营收结构	17
图表 30: 立昂微归母净利润及增速 (亿元, %, 22Q1 业绩取预告中值)	17
图表 31: 立昂微扣非净利润及增速 (亿元, %, 22Q1 业绩取预告中值)	17

图表 32: 沪硅产业营收及增速 (亿元, %)	18
图表 33: 沪硅产业归母净利润及增速 (亿元, %)	18
图表 34: 沪硅产业扣非归母净利润及增速 (亿元, %)	18

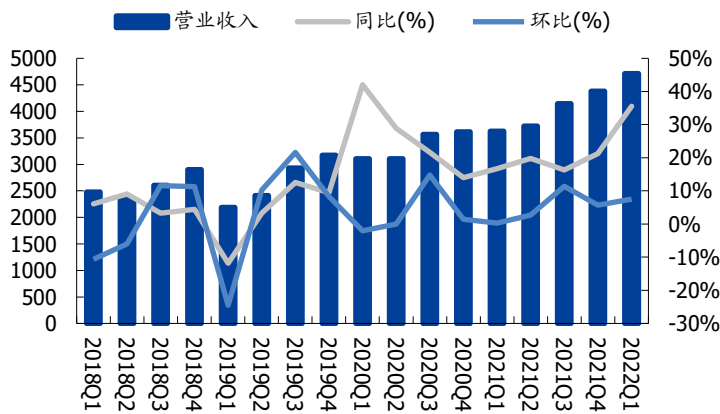
一、22Q1 全球晶圆代工厂收入亮眼，全球资本开支有望新高

1.1 台积电 3 月营收亮眼，一季度营收创新高

2022Q1 营收创历史最高。4月8日，台积电公布2022年3月营收报告显示3月台积电合并营收新台币1719.67亿，同比增长33.18%，环比增长17.04%。自2022年1月创下历史当月最高营收后，3月再一次创下历史同期最高营收，根据公司披露信息统计，台积电2022Q1实现营收4710.76亿新台币，同比增长35.50%，成为历史最高单季营收。

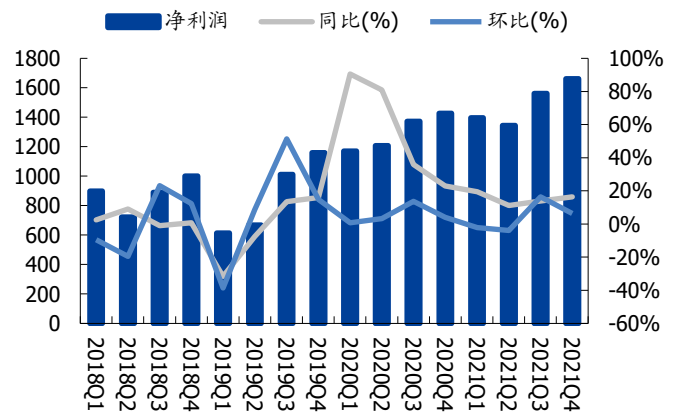
2022Q1 营收略超业绩指引中值。公司2022Q1营收指引166~172亿美元，实际营收换算美元为169.81亿，略微超越预期中值。公司2022Q1指引毛利率53-55%，营业利润率42-44%，有效税率10-11%，指引包含对了IDM客户增加内部生产的考虑。

图表1: 台积电季度营收及增速情况(新台币亿元, %)



资料来源: 台积电公告, 国盛证券研究所

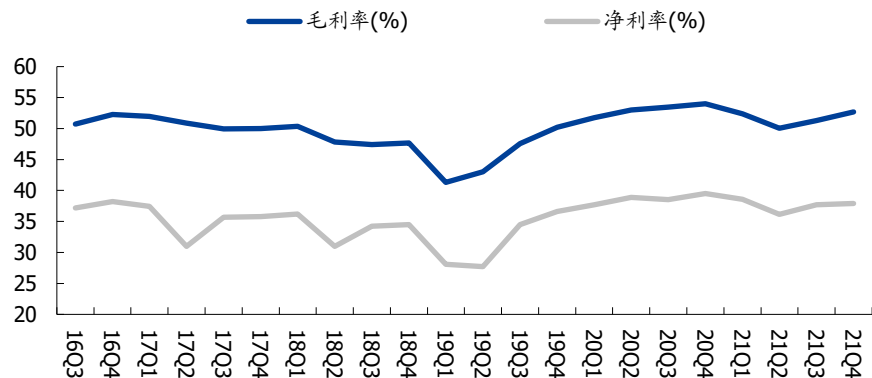
图表2: 台积电季度净利润及增速情况(新台币亿元, %)



资料来源: 台积电公告, 国盛证券研究所

毛利率贴指引上限。2021Q4毛利率52.7% (指引51.0%~53.0%), 环比提升1.4%, 主要是因为公司持续在成本改进工作上做出努力。营业利润率41.7% (指引39.0%~41.0%), 略微超出指引, 环比提升0.5%, 主要系更优经营杠杆。净利率37.9%, 环比提升0.2%。部分疫苗捐赠费用推迟到2022年第一季度。2021Q4 ROE为31.3%。

图表3: 台积电季度毛利率情况(%)



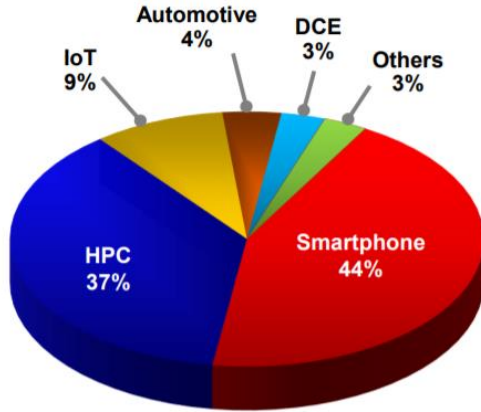
资料来源: 台积电公告, 国盛证券研究所

2021Q4 营收结构:

按下游应用: 手机占比 44%, 营收 qoq+7%, HPC 占比 37%, 营收 qoq+3%, IoT 占比 9%, qoq+3%, 汽车占比 4%, qoq+10%, 数字消费电子占比 3%, 其他 3%。

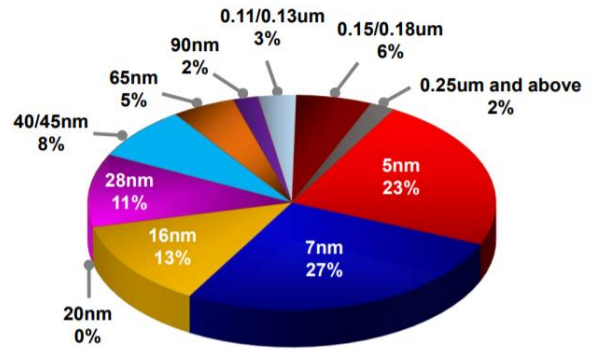
按技术节点: 5nm 贡献 23%营收, 7nm-27%, 16nm-13%, 28nm-11%。7nm 及以下 (7, 5nm) 合计贡献 50%营收。

图表 4: 台积电 2021Q4 营收下游应用结构



资料来源: 台积电官网, 国盛证券研究所

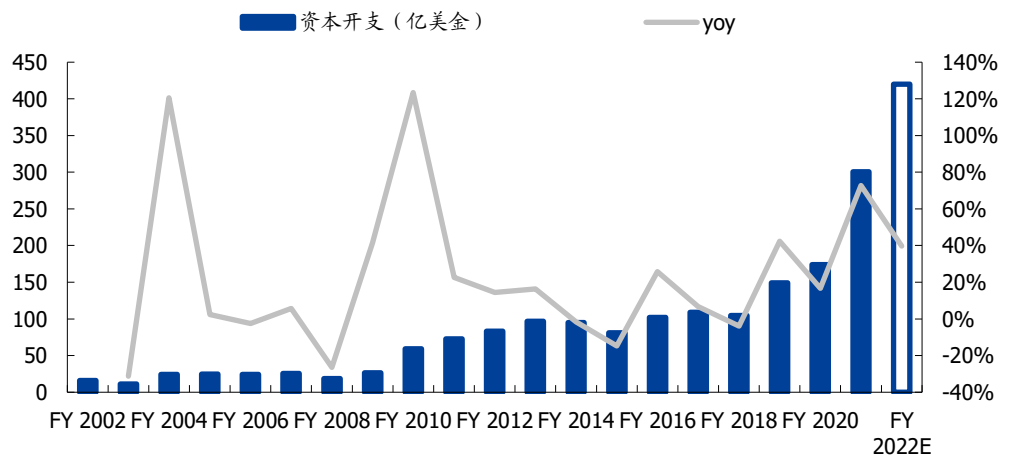
图表 5: 台积电 2021Q4 营收技术节点结构



资料来源: 台积电官网, 国盛证券研究所

2022 年仍保持大幅资本开支。台积电 2022 年全年 CapEx 指引 400-440 亿美金 (2021 年全年 300 亿美金), 以满足 5G, HPC 应用带来的多年半导体结构性高增长需求。2022 年资本开支中, 70-80%用于先进制程, 包括 2/3/5/7nm; 10%用于先进封装及掩膜版制造; 10-20%用于特殊工艺。台积电 2021 年宣布的三年 1000 亿美金资本开支以及 2022 年的大幅资本开支指引, 体现了公司对半导体行业高景气持续的信心。

图表 6: 台积电资本开支情况 (2022 年取指引中值)



资料来源: 彭博, 国盛证券研究所

台积电预期 2022 年半导体市场 (不含存储) 将增长约 9%; 代工行业增长接近 20%。公司 2022 年以美元记营收增速有望达到 mid-high 20s%, 需求来源于先进制程和特色工艺的强劲需求, 下游四大应用平台均看好。预计公司长期美元记营收 CAGR 达到 15-20%, HPC 平台会是未来营收增量最重要的来源, 其中 CPU、GPU、AI 加速器需求有望

持续增长，长期 53%+ 毛利率可以达到。

成熟制程主要扩产 28nm。公司在成熟制程方面跟客户紧密合作，终端（汽车、PC、社交、手机等领域）硅含量提升，无论先进制程还是特殊工艺需求都在增长，成熟制程中公司重点扩产 28nm，需求来源于多摄驱动的 CIS 以及非易失性存储器（NVM）等各领域需求，以及很多终端硅含量的提升。

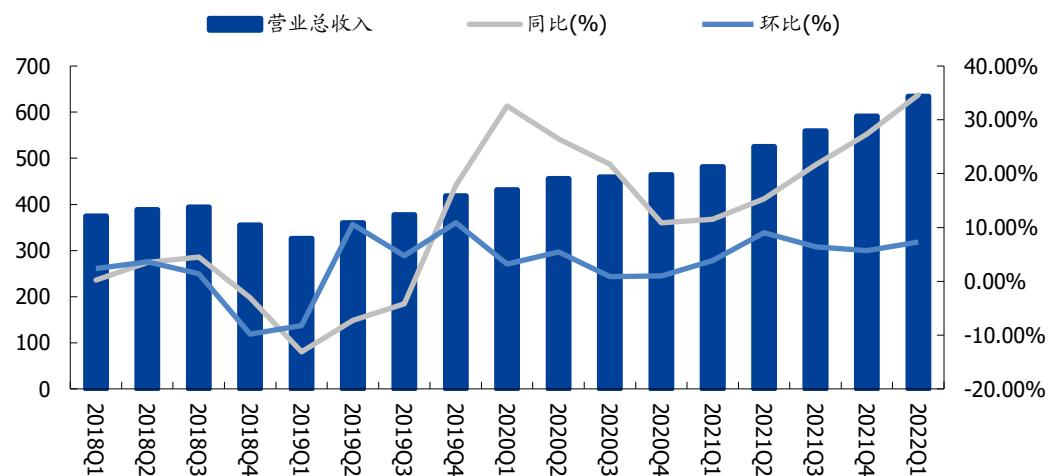
N5/N3 进展：N5 进入爬产第三年，行业竞争力强劲，预计 2022 年营收占比进一步提升；N4P 2022H2 有产品计划 Tapeout，N4X 更适用 HPC 领域，2023H1 风险试产。N3 研发符合预期，2022H2 开始生产，客户参与度比 N5 高，N3E 规模量产会在 N3 一年之后。

1.2 联电 & 世界先进：月度、季度营收创历史新高

联电：产能持续满载，有望维持 21Q42 量价向上态势

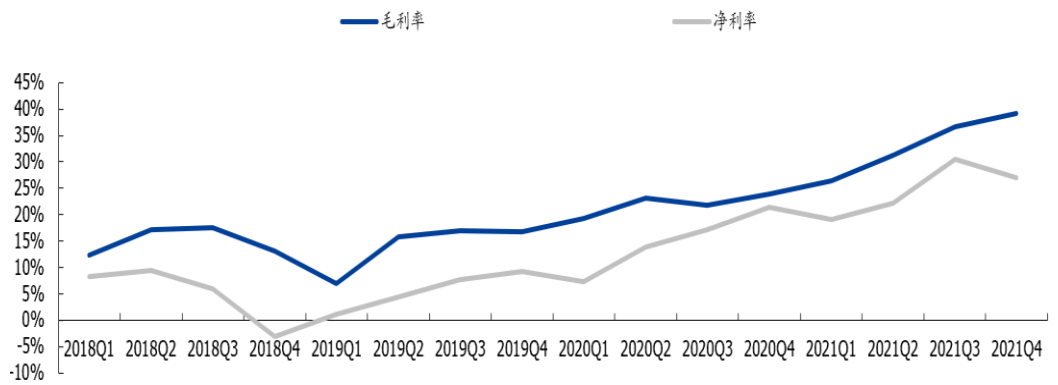
联电 3 月营收继续创历史新高。4 月 8 日，联电公布 3 月财报，3 月实现营收 221.4 亿新台币，同比增长 33.22%，环比增长 6.40%。业绩实现连续 6 个月环比增长，同时 3 月营收创下历史当月最高。根据公司公布的信息统计，联电 2022Q1 累计营收 634.23 亿新台币，同比增长 34.66%，创下历史最高单季营收。

图表 7：联电季度营收及增速情况（新台币亿元，%）



资料来源：联电公告，国盛证券研究所

图表 8: 联电季度毛利率情况 (%)



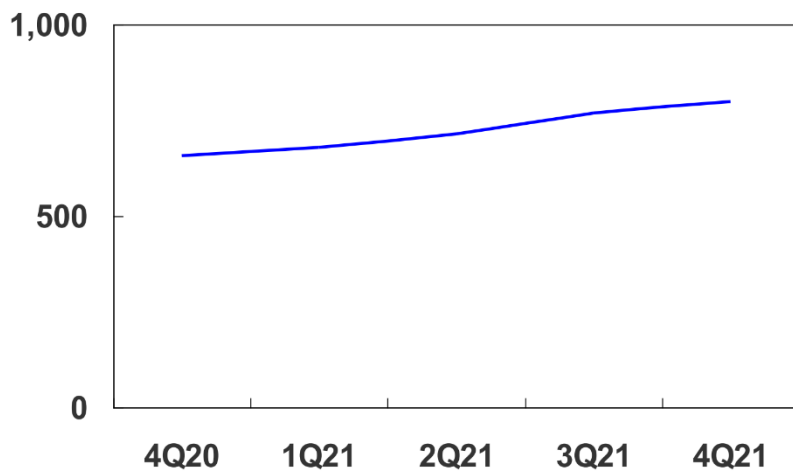
资料来源: 联电公告, 国盛证券研究所

联电 ASP 上升趋势。 ASP 的提升主要系 28 纳米技术带来的收入增长, 提升了整体晶圆平均售价, 反映了与 5G、物联网和汽车等大趋势相关的强劲芯片需求。

图表 9: 联电季度 ASP 趋势

Foundry ASP Trend : 8" Wafer Equivalent

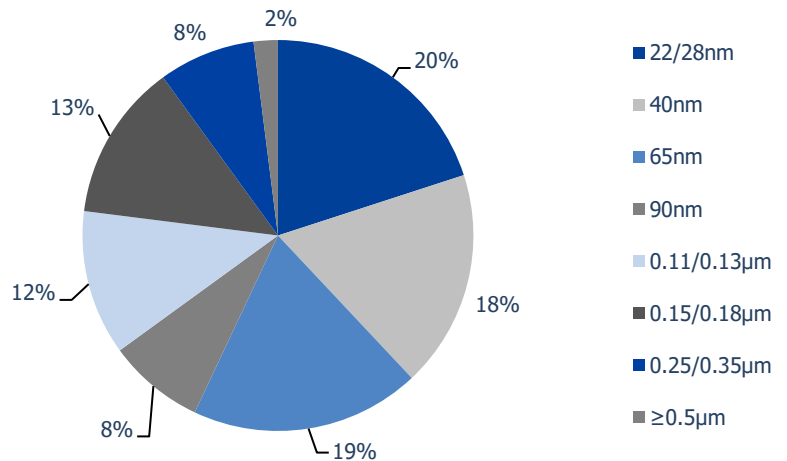
Unit: USD



资料来源: 联电公司官网, 国盛证券研究所

联电 2021 年 40nm 以下收入占 38%。 2021 年联电营收分制程来看, 22/28 纳米占比同比增长 6 个百分点至 20%, 40nm 以下的收入占总收入 38%。公司认为 2023 年之前 28nm 不会供过于求, 并且公司 28nm 需求有 80% 的长协覆盖率, 公司整体长期协议覆盖率都比较高。

图表 10: 2021 全年联电收入结构 (分制程)



资料来源: 联电公告。国盛证券研究所

产能持续满载。在 21Q4 强劲的市场需求继续推动公司晶圆厂满负荷生产, 产能利用率 100%, 整体晶圆出货量环比增长 1.7% 至 255 万片 8 英寸等值产品, 我们认为 22Q1 公司有望继续延续 21Q4 高产能利用率。

图表 11: 联电 21Q4 产能使用情况及 22Q1 产能使用预期

FAB		Unit: in thousands				
		2Q21	3Q21	4Q21	1Q22E	
WTK	(6")	84	80	81	82	
8A	(8")	190	190	190	189	
8C	(8")	115	115	115	113	
8D	(8")	95	95	95	101	
8E	(8")	115	115	115	116	
8F	(8")	122	137	137	136	
8S	(8")	102	102	102	109	
8N	(8")	230	230	232	231	
12A	(12")	271	271	271	267	
12i	(12")	160	160	164	162	
12X	(12")	74	74	78	77	
12M	(12")	98	98	104	108	
Total	(8" eq.)	2,370	2,383	2,419	2,420	

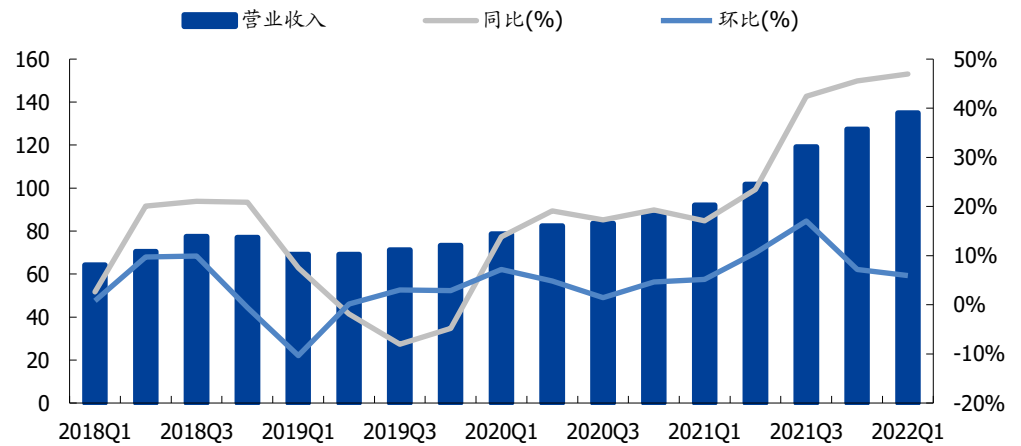
资料来源: 联电公告, 国盛证券研究所

世界先进: 收入持续增长, 资本开支进一步提高

3月世界先进营收首次突破 50 亿新台币。根据世界先进公告, 公司在 2022 年 3 月实现营收 50.68 亿新台币, 同比增长 41.42%, 环比增长 19.40%。3 月成为公司历史上营收最高的月份, 同时也是公司历史上第一次月度营收突破 50 亿新台币, 根据公司发布的月

度营收统计，2022Q1 公司实现营收 134.92 亿新台币，同比增长 46.97%。2022Q1 营收为公司历史最高值，同时公司年初规划业绩预期为 132~136 亿新台币，此次的业绩符合业绩预期且略高于预期中值。

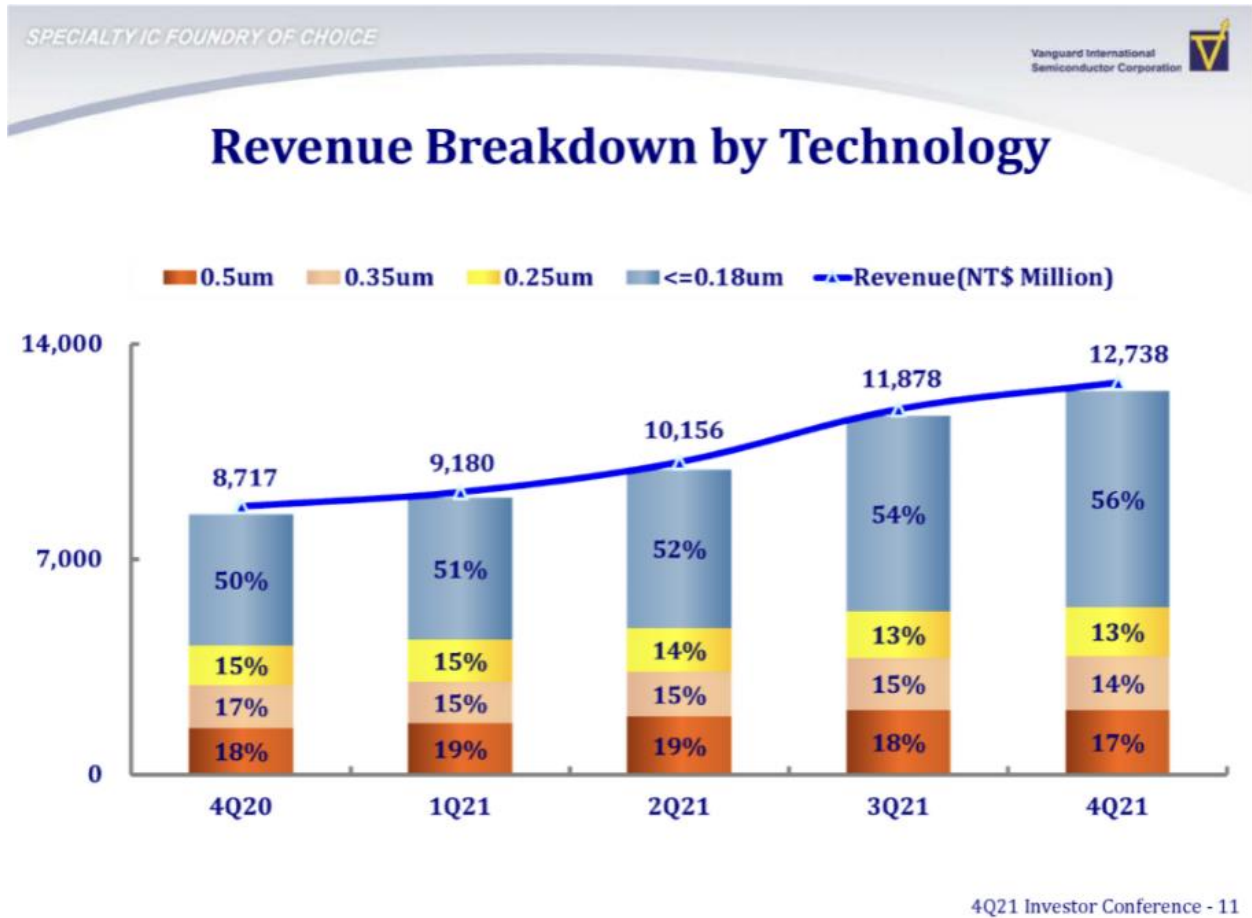
图表 12: 世界先进季度营收及增速情况 (新台币亿元, %)



资料来源: 世界先进公告, 国盛证券研究所

分制程来看， $\leq 0.18\mu\text{m}$ 制程产品大幅增长。21Q4 营收中 $\leq 0.18\mu\text{m}$ 占比 56%， $0.25\mu\text{m}$ 占比 13%， $0.35\mu\text{m}$ 占比 14%， $0.5\mu\text{m}$ 占比 17%；在过去的 5 个季度 $\leq 0.18\mu\text{m}$ 大幅增长，主要得益于晶圆三厂新产能的拓展，出货持续增长以及客户长期合约的支持。

图表 13: 世界先进收入结构



资料来源: 世界先进官网、国盛证券研究所

分产品来看，电源管理和大面板驱动 IC 占营收主要比例，营收增长主要来自电源管理和小面板驱动 IC。21Q4 营收中大面板驱动 IC 占比 27%，环比下降 2%；中小面板驱动 IC 占比 10%，环比增长 21%；电源管理占比 57%，环比增长 8%；其他占比 5%，环比增长 23%。

资本支出: 公司预估 2022 年资本支出金额将约为 240 亿元新台币，其中 75% 用于并购及翻修晶圆五厂厂路设施以及产能建制费用，20% 用于晶圆三厂的产能扩充，剩余 5% 将作为其他各厂的年度例行维修费用。

产能规划: 全年产能预计约为 314.8 万片 8 寸晶圆，与 2021 年相比将年增约 9%。2022 年 Q1 公司月产能将约 24.7 万片 8 寸晶圆，环比下降约 2%。

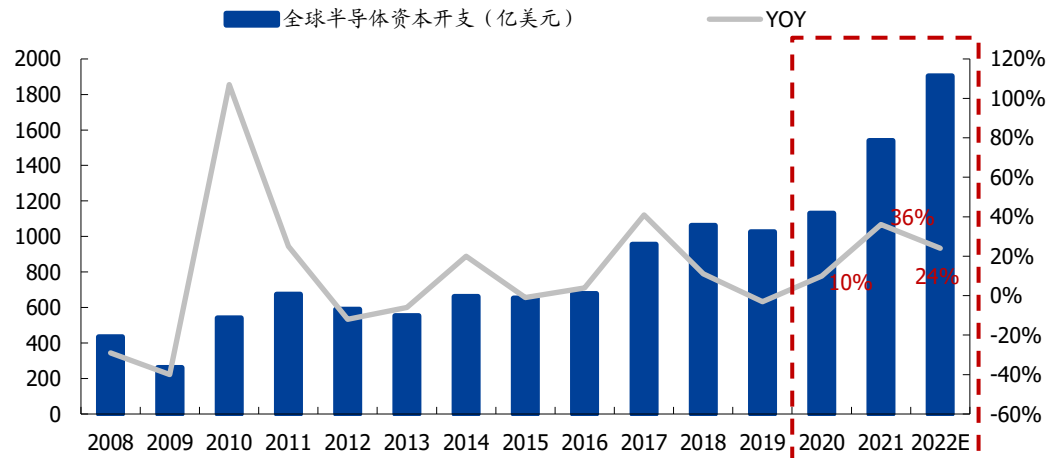
订单能见度: 由于客户对公司能持续维持强劲的代工需求，在能见度不变的情况下，预计 2022 年上半年均能维持相当高的产能利用率。

1.3 2022 全球半导体资本开支有望再创新高

根据 IC Insights 在 3 月公布数据显示，预计在 2022 年全球半导体行业资本开支有望达到 1904 亿美元，同比增长 24%。如果未来预测数据实现，这将是历史上继 1993~1995

年首次实现资本开支连续三年两位数增速后，第二次连续三年半导体资本开支增速超 10% 的情况。自 2020 年起，电子行业的需求持续超预期，全球产能利用率接近满载，预计 2020~2022 年全球半导体行业资本支出总额将达到 4574 亿美元。

图表 14: 全球半导体资本开支



资料来源: IC Insights, 国盛证券研究所

根据 IC Insights, 列举了 13 家 2022 年资本开支增速超 40% 的半导体企业, 涵盖 IC 设计 (意法半导体、英飞凌等), 代工 (台积电、联电等) 全球龙头企业, 且 13 家企业预计总支出达到 918 亿美元, 同比增长 52%, 大幅的资本开支体现了全球半导体的景气度依旧以及全球龙头公司对于行业的信心。

图表 15: 全球 2022 资本支出增速超 40% 的部分公司

Company	Headquarters	2019 (\$M)	2020 (\$M)	20/19% Change	2021 (\$M)	21/20% Change	2022E (\$M)	22/21% Change
Winbond	China Taiwan	433	284	-34%	352	24%	1,645	367%
GlobalFoundries	U.S s.	773	592	-23%	1,766	198%	4,500	155%
Nanya	China Taiwan	178	291	63%	404	39%	1,000	148%
Renesas	Japan	351	209	-40%	333	59%	800	140%
Analog Devices	U.S i.	251	174	-31%	372	114%	800	115%
ONsemi	U.s i.	535	384	-28%	445	16%	935	110%
ST	Europe	1,174	1,278	9%	1,828	43%	3,500	91%
Vanguard	China Taiwan	279	128	-54%	477	273%	865	81%
UMC	China Taiwan	566	952	68%	1,755	84%	3,000	71%
Intel	U.S s.	16,213	14,259	-12%	18,733	31%	27,000	44%
TI	U.S s.	847	649	-23%	2,462	279%	3,500	42%
Infineon	Europe	1,279	1,067	-17%	1,637	53%	2,300	41%
TSMC	China Taiwan	14,937	17,240	15%	30,043	74%	42,000	40%
Total		37,816	37,507	-1%	60,607	62%	91,845	52%

资料来源: IC Insights, 国盛证券研究所

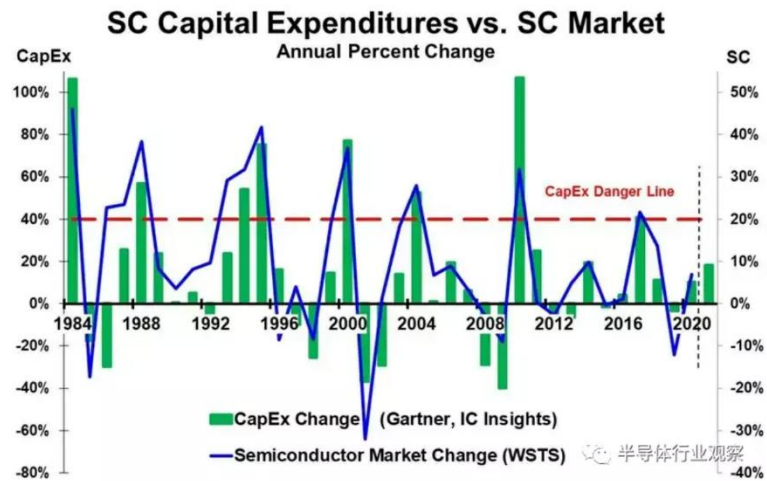
根据 IC Insights 数据显示, 结合 2021 年全球资本开支情况展望 2022, 在 2021 年代工环节为资本开支最集中的部分, 预计在 2021 年占整体资本开支 35%, 也可以看出半导体行业对于先进工艺制程的需求在不断上升, 代工厂的支出变得必要且重要。2022 年我们认为整体的资本开支占比与 2021 年持平, 代工依旧将作为资本开支的集中部分。

图表 16: 2021 年预计代工占资本开支 35%

Product	19 (\$B)	19/18 % Change	20 (\$B)	20/19 % Change	21F (\$B)	21/20 % Change
MPU/MCU	\$16.9	12%	\$16.5	-2%	\$23.5	42%
% of Total	17%	-	15%	-	15%	-
Logic	\$8.5	6%	\$8.8	4%	\$12.4	40%
% of Total	8%	-	8%	-	8%	-
Foundry	\$26.2	18%	\$37.3	42%	\$53.0	42%
% of Total	26%	-	33%	-	35%	-
DRAM/SRAM	\$19.1	-17%	\$17.9	-6%	\$24.0	34%
% of Total	19%	-	16%	-	16%	-
Flash/Non-Volatile	\$22.6	-19%	\$24.6	9%	\$27.9	13%
% of Total	22%	-	22%	-	18%	-
Analog/Other	\$9.0	-7%	\$7.9	-12%	\$11.2	41%
% of Total	9%	-	7%	-	7%	-
Total	\$102.5	-3%	\$113.1	10%	\$152.0	34%

资料来源: IC Insights, 国盛证券研究所

图表 17: 全球半导体市场规模及 Capex 支出增速对比



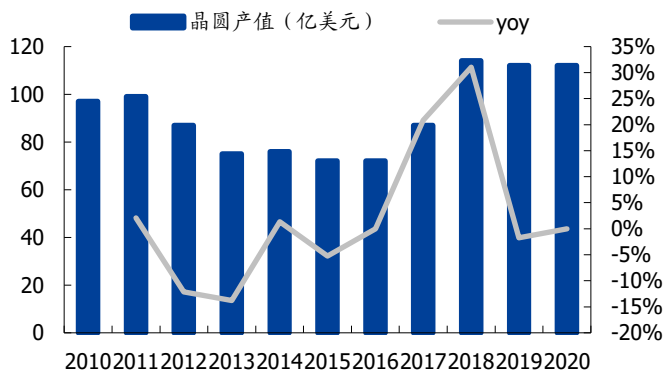
资料来源: IC Insights, 国盛证券研究所

二、硅晶圆供应持续紧张，晶圆厂 22Q1 业绩亮眼

2.1 硅片行业景气度迎接数年上行周期

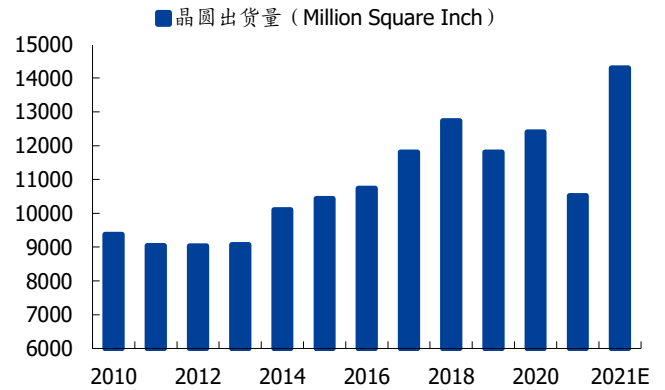
由于半导体行业与全球宏观形势紧密相关，全球半导体硅片行业在 2009 年受经济危机影响，出货量与销售额均出现下滑；2010 年智能手机放量增长，硅片行业大幅反弹；2011 年-2016 年，全球经济复苏但较为低迷，硅片行业易随之低速发展；2017 年以来，得益于半导体终端市场需求强劲，半导体市场规模不断增长，于 2018 年突破百亿美元大关。至 2020 年全球半导体硅片的收入已经达到 112 亿美元的规模，且至 2021 年出货量有望也达到了 143 亿平方英寸。

图表 18: 全球半导体硅片收入 (亿美元)



资料来源: SEMI, 国盛证券研究所

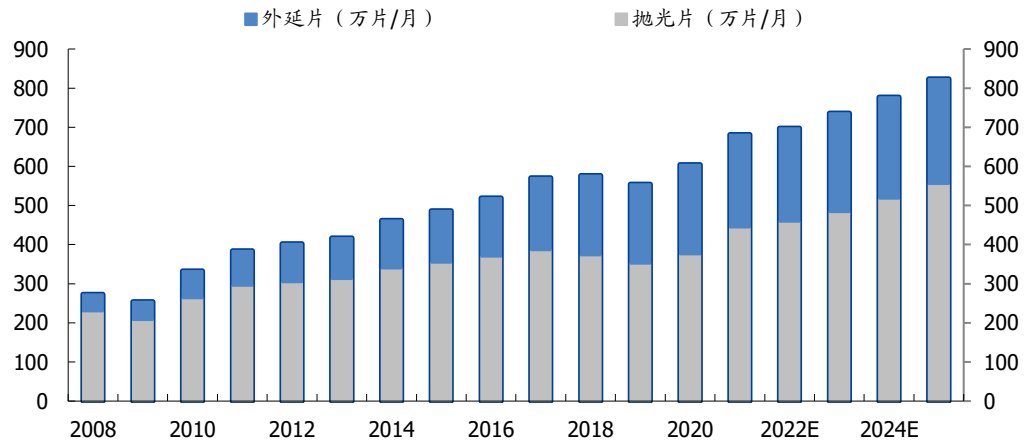
图表 19: 全球半导体硅片出货面积 (百万平方英寸)



资料来源: SEMI, 国盛证券研究所

随着未来全球晶圆厂的持续扩张，并且主要的方向将会集中在 12 寸晶圆上，我们认为硅片行业的主要发展方向将会集中在 12 寸硅片上。

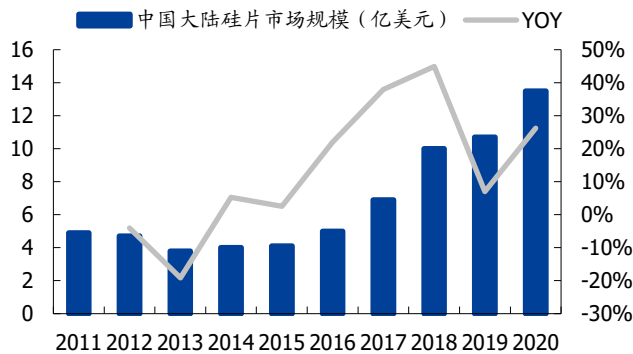
图表 20: 全球 12 寸半导体硅片需求



资料来源: Sumco, 国盛证券研究所

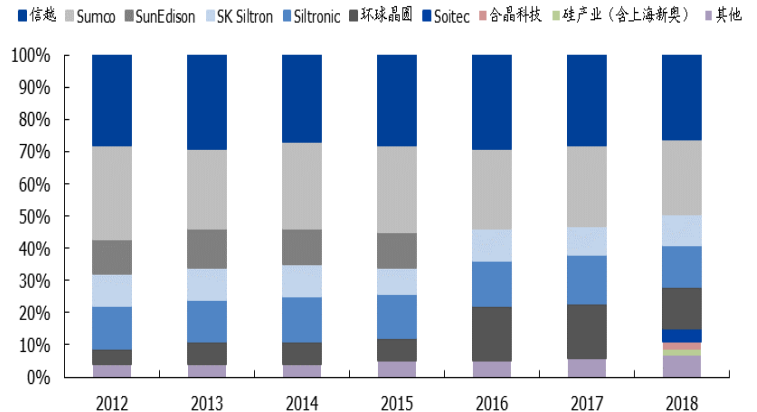
2008 年至 2013 年, 中国大陆半导体硅片市场发展趋势与全球半导体硅片市场一致。2014 年起, 随着中国半导体制造生产线投产、中国半导体制造技术的不断进步与中国半导体终端市场的飞速发展, 中国大陆半导体硅片市场步入飞跃式发展阶段。2016 年-2020 年, 中国半导体硅片销售额从 5.00 亿美元上升至 13.5 亿美元, 年均复合增长率高达 41.17%。中国作为全球最大的半导体终端市场, 未来随着中国芯片制造产能的持续扩张, 中国半导体硅片市场的规模将继续以高于全球市场的速度增长。

图表 21: 中国大陆半导体硅片市场规模 (亿美元)



资料来源: SEMI, 国盛证券研究所

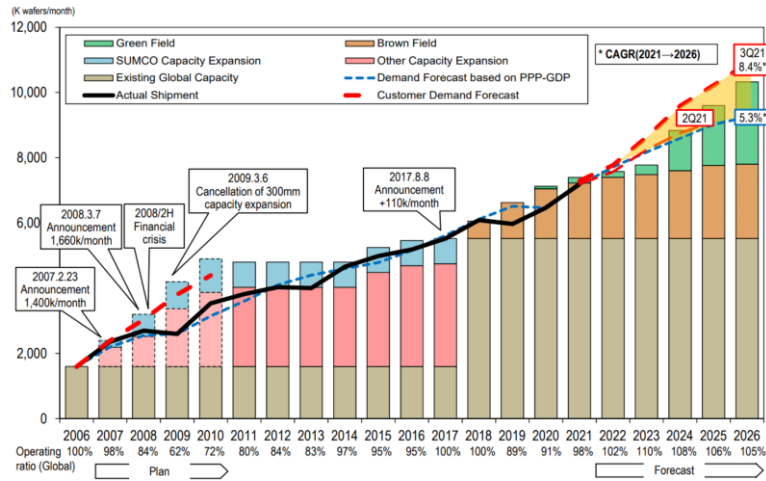
图表 22: 全球硅片市场竞争格局及市占率



资料来源: 各公司资料, 芯思想, 国盛证券研究所

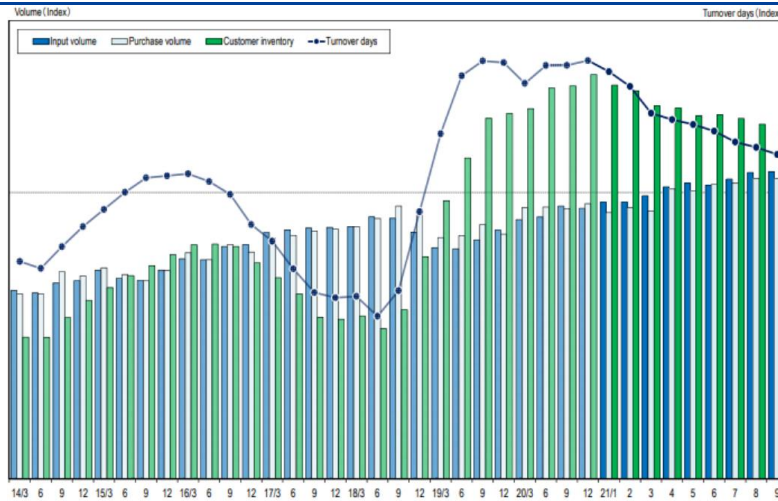
全球硅片行业或即将进入供不应求, 行业供需紧平衡或将推动半导体硅片涨价潮。我们根据全球前三大的硅片供应商 SUMCO 在 21Q3 法说会材料可见, 全球硅片的供需关系在 2021 年达到了正好平衡的状态, 供给与需求之比为 98%; 然而硅片行业扩产周期较长 (新扩产周期平均超过 2.5 年), 且海外前五大硅片供应商的扩产均在 2020-2021 年推出, 然而全球半导体晶圆产能的增长却是逐季增长, 因此我们认为全球的硅片需求或将在未来的 3 年~5 年内进入紧缺的通道。而供需不平衡的基础上, 我们认为短供的硅片有望进入涨价周期, 且维持 3-5 年的时间长度, 带动硅片行业的景气上行。

图表 23: 全球硅片产能及需求变化情况及预测



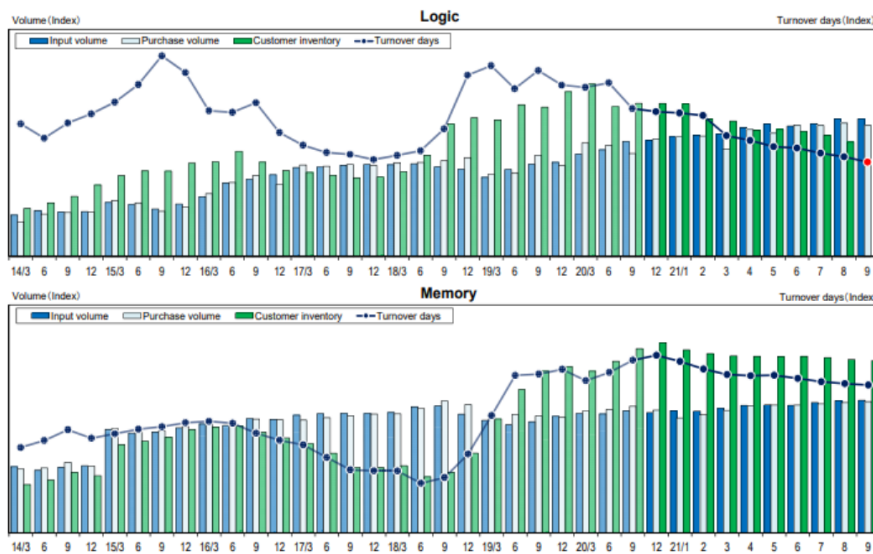
资料来源: Sumco 法说会材料, 21Q3, 国盛证券研究所

图表 24: 下游晶圆厂库存采购、需求、及库存、库存周转天数情况



资料来源: Sumco 法说会材料, 21Q3, 国盛证券研究所

图表 25: 下游晶圆厂库存采购、需求、及库存、库存周转天数情况 (逻辑及存储芯片)



资料来源: Sumco 法说会材料, 21Q3, 国盛证券研究所

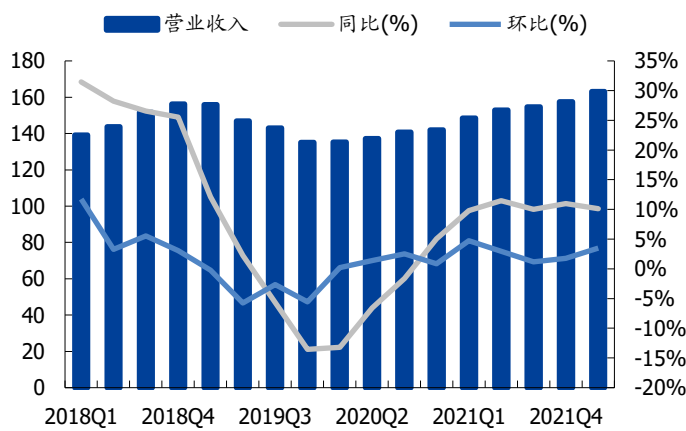
2.2 晶圆厂 2022 一季度业绩亮眼

环球晶圆：22Q1 营收创新高，子公司新建 12 寸晶圆产能

4月6日公司发布公告，3月公司营收为57.34亿新台币，同比增长7.05%，环比增长0.55%。根据公司公布的月度营收，22Q1累计实现营收163.07亿新台币，同比增长10.14%。预计公司一季度将创下历史最高营收，同时受益于去年四季度的晶圆涨价，公司毛利率水平持续走高，21Q4公司实现毛利率41.3%，创下历史最高。

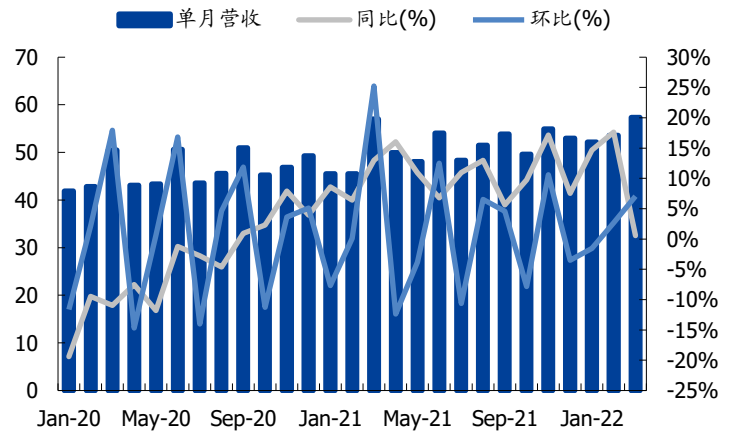
公司在法说会中表示目前半导体产能依旧短缺，同时先进制程晶圆需求持续扩大，公司长约覆盖率增加、ASP持续上涨。目前公司产能持续满载，2022~2024年产能均已售空，8寸、12寸产品需求强劲。

图表 26: 环球晶圆季度营收及增速情况 (新台币亿元, %)



资料来源: 环球晶圆公告, 国盛证券研究所

图表 27: 环球晶圆月度营收及增速情况 (新台币亿元, %)



资料来源: 环球晶圆公告, 国盛证券研究所

扩产计划: 公司在3月15日宣布, 意大利的子公司 MEMC SPA 将新建 12 英寸晶圆的产线, 并且有望在 2023 年下半年开出产能。该晶圆厂有望成为意大利地区第一座 12 寸晶圆厂, 将专注于 12 寸抛光和外延晶圆, 未来该项目落地后, 环球晶圆将拥有完整的 12 寸生产线。目前环球晶圆在全球范围内拥有 16 处运营基地, 产品涵盖外延、抛光、扩散等晶圆, 广泛应用于电源管理芯片、车用功率器件、MEMS 元件等领域。

资本开支: 2022 年预计执行 1000 亿新台币 (折合 36 亿美元) 的资本开支计划, 主要用于新增 12 英寸硅片和化合物半导体产能, 投资地区涵盖亚洲、欧洲、美国。

立昂微: 22Q1 利润同比增长 183.66%~223.24%

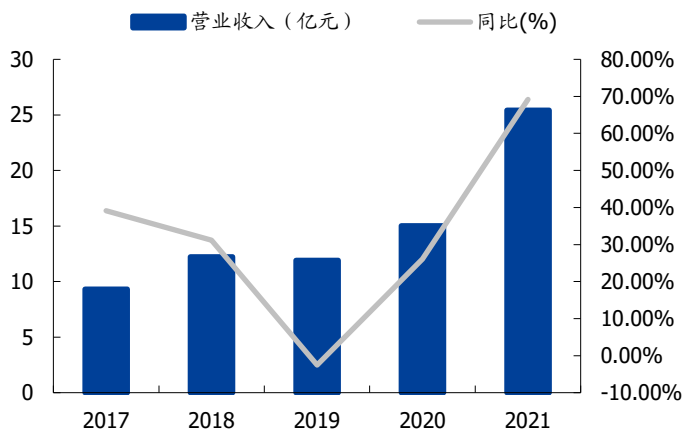
22Q1 盈利能力大增。立昂微发布公告, 公司 2022 年第一季度实现归母净利润 2.15~2.45 亿, 同比增长 183.66%~223.24%, 扣非净利润 2.12~2.42 亿, 同比增长 220.50%~265.85%。受益于国产替代的加速以及下游应用的火热, 公司订单持续饱满, 主要的产品销量大幅提升。

产能吃紧, 硅片供不应求。根据公司年报, 2021 年立昂微硅片收入 14.59 亿, 同比增加 49.85%, 营收占比 57.40%。公司 6 英寸硅片产线、8 英寸硅片产线长期处于满负荷运转状态, 产品供不应求。在 12 英寸硅片规模上量明显, 技术及量产能力实现突破, 在 2021 年底已经实现 180 万片量产规模。

收购国晶, 扩大 12 寸产能。2 月立昂微宣布收购国晶半导体 58.69% 股权, 交易完成后

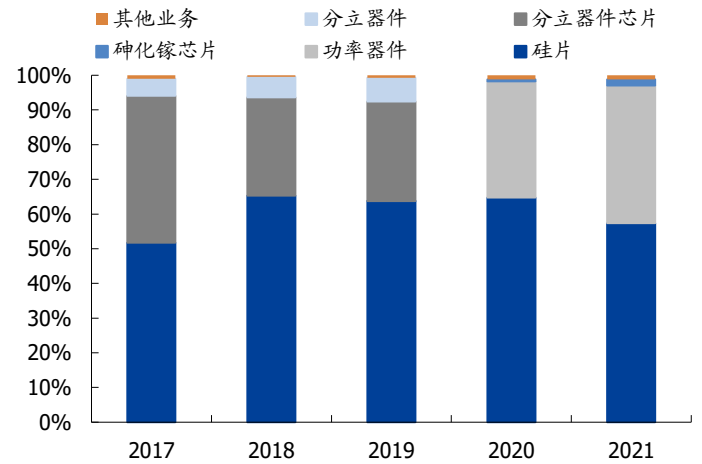
将累计持有国晶半导体 77.97% 股权。通过并购进一步扩大 12 英寸硅片产能，加强轻掺抛光硅片业务，未来公司将同时发挥重掺、轻掺优势，努力加速 12 英寸硅片的国产化进程。

图表 28: 立昂微营收及增速 (亿元, %)



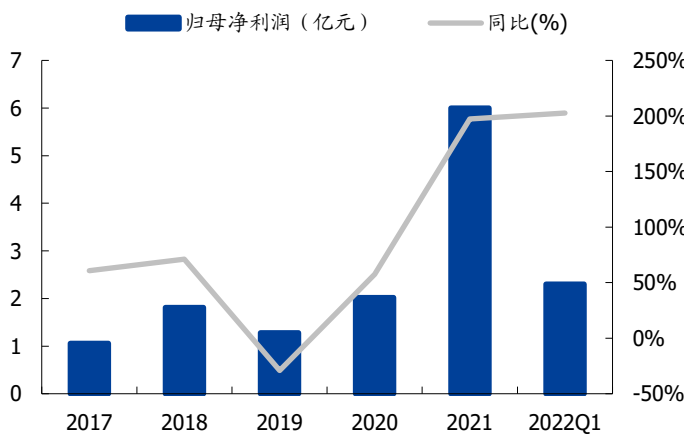
资料来源: Wind, 国盛证券研究所

图表 29: 立昂微营收结构



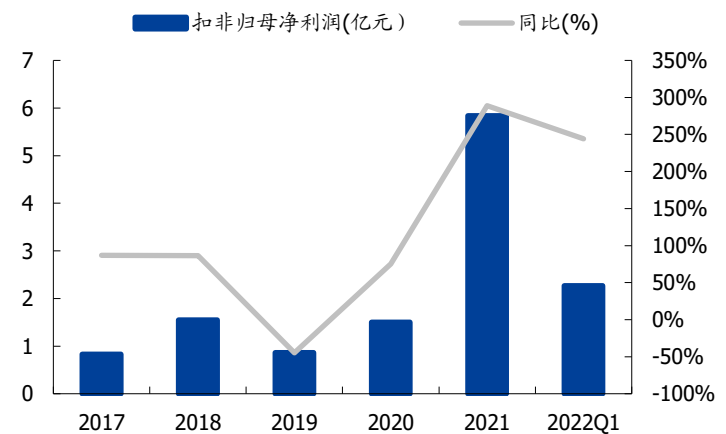
资料来源: Wind, 国盛证券研究所

图表 30: 立昂微归母净利润及增速 (亿元, %, 22Q1 业绩取预告中值)



资料来源: Wind, 公司公告, 国盛证券研究所

图表 31: 立昂微扣非净利润及增速 (亿元, %, 22Q1 业绩取预告中值)



资料来源: Wind, 公司公告, 国盛证券研究所

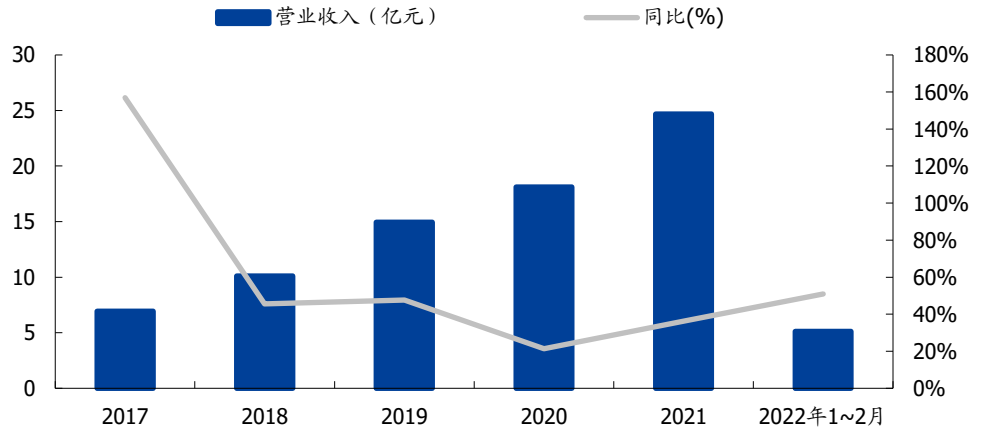
沪硅产业: 1~2 月营收同比增长 51%

1~2 月公司经营情况亮眼, 减亏 74%。公司发布公告, 2022 年 1~2 月公司实现营收 5.11 亿, 同比增长约 51%; 扣非归母净利润-806 万, 减亏约 2376 万, 约为 74%。

2021 年业绩快报, 预计全年实现营收 24.67 亿元, 同比增长 36.2%, 实现归母净利润 1.45 亿元, 同比增长 66.6%, 归母扣非净利润-1.31 亿元, 较 2020 年的-2.81 亿元收窄 1.50 亿元。得益于市场需求持续旺盛, 公司的产能陆续释放, 业绩增速显著。

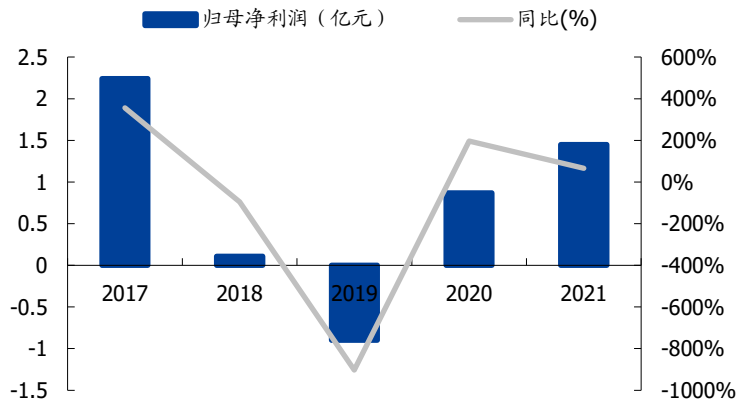
定增再扩 12 寸产能, 大基金认购 15 亿元彰显信心。公司定增拟总投资 46 亿元用于研发及扩产用于先进制程的 12 英寸硅片, 投产后新昇二期将新增产能 30 万片/月, 此外公司还将投资 21.44 亿元用于 12 英寸 SOI 硅片, 新傲将完成建设 SOI 产能 40 万片/年。本次定增总募集资金 50 亿元, 大基金二期认购 15 亿元彰显信心。

图表 32: 沪硅产业营收及增速 (亿元, %)



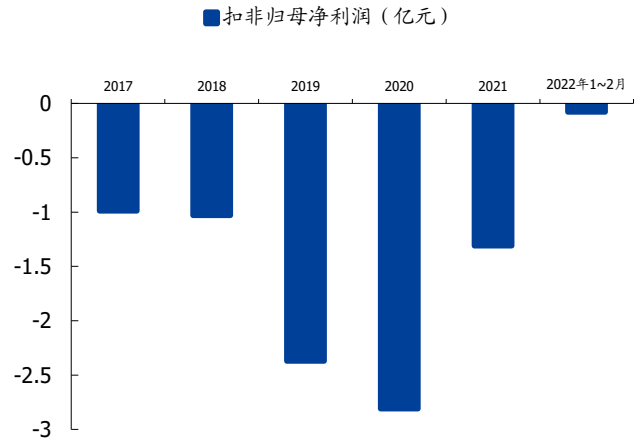
资料来源: Wind, 公司公告, 国盛证券研究所

图表 33: 沪硅产业归母净利润及增速 (亿元, %)



资料来源: Wind, 国盛证券研究所

图表 34: 沪硅产业扣非归母净利润及增速 (亿元, %)



资料来源: Wind, 公司公告, 国盛证券研究所

三、投资建议

【半导体核心设计】

韦尔股份、卓胜微、兆易创新、恒玄科技、圣邦股份、芯朋微、晶丰明源、思瑞浦、芯原股份;

【军工芯片】

紫光国微、景嘉微;

【功率】

华润微、士兰微、斯达半导、扬杰科技、新洁能;

【半导体代工、封测及配套】

I D M: 三安光电、闻泰科技、士兰微;

晶圆代工: 中芯国际、华润微;
封测: 长电科技、通富微电、深科技、华天科技、晶方科技;
材料: 彤程新材、鼎龙股份、兴森科技、安集科技、雅克科技、
沪硅产业、立昂微、晶瑞股份、上海新阳、南大光电;
设备: 北方华创、中微公司、芯源微、华峰测控、长川科技、精测电子、
至纯科技、万业企业、盛美上海;

【智能汽车】

车载光学: 韦尔股份、晶方科技、舜宇光学、永新光学、联创电子
MCU、存储: 兆易创新、北京君正
IGBT、SiC: 三安光电、斯达半导、时代电气、凤凰光学、北方华创、
闻泰科技、晶盛机电、士兰微、华润微、新洁能
GPU: 景嘉微
连接器: 立讯精密、永贵电器、瑞可达、电连技术、鼎通科技

【苹果链龙头】

立讯精密、歌尔股份、京东方、欣旺达、领益智造、大族激光、鹏鼎控股、比亚迪电子、
工业富联、信维通信、东山精密、长盈精密;

【光学】

瑞声科技、舜宇光学、丘钛科技、欧菲光、水晶光电、联创电子、苏大维格;

【消费电子】

精研科技、杰普特、科森科技、赛腾股份、智动力、长信科技;

【面板】

京东方 A、TCL 科技、激智科技;

【元器件】

火炬电子、三环集团、风华高科、宏达电子;

【PCB】

鹏鼎控股、生益科技、景旺电子、胜宏科技、东山精密、弘信电子;

【安防】

海康威视、大华股份。

四、风险提示

下游需求不及预期: 若下游市场的增速不及预期,供应链公司的经营业绩将受到不利影响。

中美科技摩擦: 若中美科技摩擦进一步恶化,将对下游市场造成较大影响,从而对供应链公司造成不利影响。

免责声明

国盛证券有限责任公司（以下简称“本公司”）具有中国证监会许可的证券投资咨询业务资格。本报告仅供本公司的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。

本报告的信息均来源于本公司认为可信的公开资料，但本公司及其研究人员对该等信息的准确性及完整性不作任何保证。本报告中的资料、意见及预测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，可能会随时调整。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。本公司不保证本报告所含信息及资料保持在最新状态，对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。

本公司力求报告内容客观、公正，但本报告所载的资料、工具、意见、信息及推测只提供给客户作参考之用，不构成任何投资、法律、会计或税务的最终操作建议，本公司不就报告中的内容对最终操作建议做出任何担保。本报告中所指的投资及服务可能不适合个别客户，不构成客户私人咨询建议。投资者应当充分考虑自身特定状况，并完整理解和使用本报告内容，不应视本报告为做出投资决策的唯一因素。

投资者应注意，在法律许可的情况下，本公司及其本公司的关联机构可能会持有本报告中涉及的公司所发行的证券并进行交易，也可能为这些公司正在提供或争取提供投资银行、财务顾问和金融产品等各种金融服务。

本报告版权归“国盛证券有限责任公司”所有。未经事先本公司书面授权，任何机构或个人不得对本报告进行任何形式的发布、复制。任何机构或个人如引用、刊发本报告，需注明出处为“国盛证券研究所”，且不得对本报告进行有悖原意的删节或修改。

分析师声明

本报告署名分析师在此声明：我们具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力，本报告所表述的任何观点均精准地反映了我们对标的证券和发行人的个人看法，结论不受任何第三方的授意或影响。我们所得报酬的任何部分无论是在过去、现在及将来均不会与本报告中的具体投资建议或观点有直接或间接联系。

投资评级说明

投资建议的评级标准		评级	说明
评级标准为报告发布日后的6个月内公司股价（或行业指数）相对同期基准指数的相对市场表现。其中A股市场以沪深300指数为基准；新三板市场以三板成指（针对协议转让标的）或三板做市指数（针对做市转让标的）为基准；香港市场以摩根士丹利中国指数为基准，美股市场以标普500指数或纳斯达克综合指数为基准。	股票评级	买入	相对同期基准指数涨幅在15%以上
		增持	相对同期基准指数涨幅在5%~15%之间
		持有	相对同期基准指数涨幅在-5%~+5%之间
		减持	相对同期基准指数跌幅在5%以上
	行业评级	增持	相对同期基准指数涨幅在10%以上
		中性	相对同期基准指数涨幅在-10%~+10%之间
		减持	相对同期基准指数跌幅在10%以上

国盛证券研究所

北京

地址：北京市西城区平安里西大街26号楼3层

邮编：100032

传真：010-57671718

邮箱：gsresearch@gszq.com

南昌

地址：南昌市红谷滩新区凤凰中大道1115号北京银行大厦

邮编：330038

传真：0791-86281485

邮箱：gsresearch@gszq.com

上海

地址：上海市浦明路868号保利One56 1号楼10层

邮编：200120

电话：021-38124100

邮箱：gsresearch@gszq.com

深圳

地址：深圳市福田区福华三路100号鼎和大厦24楼

邮编：518033

邮箱：gsresearch@gszq.com